

2018 하반기 LG전자 신입사원 정시채용

◆ 지원 자격

- 대상** 2019년 2월 졸업 예정자 및 기졸업자 (학사/석사/박사)
학위 국내/해외에서 학사/석사/박사 또는 이와 동등한 효력이 인정되는 자격을 취득(예정)한 자
병역 군필자 또는 면제자에 한함
어학 자사 기준에 준하는 공인 영어 성적 보유자 (서류 접수 마감일 기준 2년 이내 유효 성적에 한함, 단 영어권 국가의 4년제 해외대 학위 취득자는 어학 성적 제출 대상에서 제외)

해당 직무	TOEIC	TOEIC Speaking	OPIc
Sales, 해외영업, Finance, IT	700이상	Level 6 이상	IM 이상

※ OPIc 등급 중 IM 등급은 IM1, IM2, IM3으로 나누어 입력함
 ※ 상기 직무 외에는 어학 점수를 입력하셔도 서류전형에 반영되지 않습니다. 단, 면접 대상자에 한하여 별도 어학 성적을 요청 또는 자체 어학 Test를 실시할 예정입니다.
 ※ 해외영업 지원자의 경우 면접 대상자에 한하여 제2외국어 어학 Test를 실시할 예정입니다.

- 기타**
- 해외 여행에 결격 사유가 없는 경우에 한함
 - 산학장학생은 별도 모집 프로그램으로 선발함
 - 입사지원서 및 채용 전형 과정에서 허위 사실이 발각될 경우는 입사가 취소될 수 있음
 - 졸업예정자의 경우 입사 후 3개월 내 학위증명서를 제출하지 못할 시 입사가 취소될 수 있음
 - 취업 보호 대상자(보훈 대상자/장애인)는 관련 법규 등에 의거하여 우대함
 ※ 면접 또는 최종 합격시 해당 증명서 제출자에 한함

◆ 일정 및 프로세스



1차 서류 전형 입사지원서를 기준으로 지원 분야에 해당하는 필요 역량을 갖추었는지를 판단
인/적성 검사 LG Way 와의 적합성 확인 및 언어/수리 등 기본 역량 평가

구분	검사 내용	문항 수	소요 시간
인성검사 (LG Way Fit Test)	지원자와 LG Way 간의 적합성 확인	342문항	50분
적성 검사*	언어이해/ 언어추리/ 인문역량/ 수리력/ 도형추리/ 도식적추리	125문항	140분

* 문항예제는 careers.lg.com에서 확인할 수 있습니다.

직무지필시험 기본적인 직무 능력을 갖추었는지를 평가

직무	검사 내용	문항 수	소요 시간	응시일
R&D_SW	C, JAVA 프로그래밍 관련	70 문항	100분	10월 13일(토) 인/적성 검사와 동일한 날 실시
R&D_HW	전기공학, 전자공학	80문항	100분	
R&D_기구	기계공학	40문항	50분	
Finance	기초회계 관련	20문항	50분	
IT	IT 직무 관련	25문항	50분	

면접 전형 직무별 다양한 모듈을 통해 지원자의 직무/인성을 종합적으로 평가

구분	검사 내용
직무 면접	직무 지식 및 직무 적합도 검증
인성 면접	LG Way 형 인재 검증



지원 분야

본부	직무	주요 업무/역할	관련 전공						근무지
			전기/전자	기계	컴퓨터/SW	소재/재료	경영/경제	기타 전공	
H&A본부	HW	- Sensor Application, 구동 Drive, 모터 응용 설계(전동기 설계 및 제어, 인버터, IH) 등	●						서울/창원
	SW	- 시스템 알고리즘 (지능제어, 신호처리), Smart 기술 등 - 로보틱스(Robot Tech, Mapping&Navigation, Robust SLAM, Vision&Sensor)	●		●				서울/창원
	기구	- 열 유체 유동설계, 구조 설계, 해석 (응용역학, CAD/CAE/CAM, 최적설계) - 강성, 동역학, 피로해석, 진동/소음 분석 및 평가 등		●		●			서울/창원
HE본부	HW	- 제품 회로 설계(방송 수신부, Video, Audio 신호처리 설계), 그에 따른 전력 설계 및 회로 해석	●						평택
	SW	- SW플랫폼(webOS) 설계, Middleware, Application, SW 보안 설계 - 방송수신, 신호처리, 유무선 네트워크 처리, 미디어 플레이어 관장	●		●				서울/평택
	기구	- 각종 디스플레이 제품 기구 구조 연관기술 개발, 기구 구조 설계/분석, 열해석, 소재 발굴, 표면 처리, 광학 개발		●		●			평택
MC본부	HW	- RF/Antenna설계: RF 회로 설계, Antenna 패턴/매칭 설계, ESD/EMC 저감 설계 등 - Processor 회로설계: Baseband(AP/Modem) 및 주변 회로 설계, Power Management, HW 성능분석 및 개선 - Analog Circuit 회로설계 - Packaging 기술개발: 고밀도 실장 PCB 설계, 부품별 최적 설계	●		●				서울
	SW	- Android기반 Framework/Application 개발: Multimedia, Telephony, Security, Connectivity, Intelligent - 무선통신 Protocol: Radio/Data/Rf SW(5G), Connectivity(Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC) 개발 - BSP: Linux Kernel, Device Driver (Camera/Display/Touch 등), Power management 개발	●		●				
	기구	- System/Component Design: HW/부품/기구 간 최적 구조 제품 설계, 재질/표면처리 등을 고려한 부품 설계 - Design Verification: 충격 해석, 구조 분석, 열해석, M-CAD/3D Printer 활용		●					
VC본부	HW	- IV(In-Vehicle Infotainment) HW개발 - Motor, Inverter, Converter, Power Electronics, 센서제어 등 - 고전압 시스템 회로설계, 차량용램프 전장설계 HW 시스템, EMC/EMI 설계, LCD/OLED 회로/Interface 등	●					● (자동차)	서울/인천
	SW	- IV(In-Vehicle Infotainment) App. S/W, Middleware, Network, Connectivity(Bluetooth, Wifi), ADAS, Vision 알고리즘 - EV(Electric Vehicle)용 부품 제어SW, SW 품질 관리, Test Manager	●		●				
	기구	- IV(In-Vehicle Infotainment)기구 및 구조설계 - Motor 및 고전압 대용량 Inverter, Converter 기구 설계 - 배터리 모듈/팩 기구 설계 및 제작, 열관리 시스템 설계, Drive Unit 구조 설계, 차량용램프 기구설계 등		●				● (자동차)	
B2B본부	HW	- B2B 디스플레이 제품 관련한 회로 설계 (Image Processing & Computer Vision, Speech & Audio Processing, Virtual / Augmented Reality)	●						평택
	SW	- SW플랫폼 개발 (webOS Core, Web technology, Security, Media Streaming, SDK, BSP, Linux Kernel, Compiler) - Data Mining & Analysis (Data collection, ETL, Dashboard, Design & Establishment of Data Service Platform)	●		●				서울/평택
	기구	- B2B 디스플레이 제품의 구조 설계 / 분석 / 해석 및 소재 발굴 / 광학 개발 / 선행 기술 개발		●		●			평택
CTO부문	HW	- Analog/Digital Circuit Design, CMOS Integrated Circuit, Electric Machinery	●		●				서울
	SW	- Application, Middleware, Network, OS Kernel, SW Engineering, Platform, Cloud Computing & Service Development	●						
	기구	- Motor, Inverter, Converter, Power Electronics, SoC Design, 센서제어 등	●	●					
	Content & Service	- 빅데이터 분석 과제 발굴, 분석 서비스/컨설팅 - 빅데이터 분석 플랫폼 개발, 운영 - 빅데이터 기반 B2B 솔루션화 및 사업화 추진	●		●			● (통계)	
소재/생산기술원	HW	- 장비 운영SW, 제어 알고리즘, 영상처리, Machine Vision, 로보틱스 - 고속/무선 신호전송, 파워회로 설계, 마이크로 패키징	●						평택
	SW	- 장비운영 SW, 제어 알고리즘 개발, 영상처리 SW, Machine Vision	●		●				
	기구	- 장비 설계, Lay Out 설계, 정밀 구동부/강성 구조설계, 광학 모듈 설계 - 로보틱스, 구조/충격/강성 해석 및 최적 설계, 열유동/진동소음 설계 및 해석 - 고속/무선 신호전송, 파워회로 설계, 마이크로 패키징		●					
	Production R&D	- 생산시스템 설계/검증, 생산전략 수립/계획 최적화, 제품 Architecture 표준 설계/개발 - 제조지능화 솔루션(Big Data, AI, 머신러닝, 딥러닝 기반), 제조 ICT 플랫폼 - 금속/알루미늄 가공 기술, 플라스틱 및 복합소재 개발/응용, CMF 기술 - 생산요소기술(융합/주조/제결/실링 등), 정정환경솔루션(이물제어, 클린룸 등)	●	●	●			● (산업공학)	
	Material & Device	- 센서, 복합 소재, 광학, 차세대 디스플레이 - 금속, 나노 소재, 물성분석, 방열, 단열 소재 개발 등	●			●		● (이공계)	
한국영업본부	Sales & Marketing	- B2B: B2B채널(기업, 유통, 건설, 조달)영업관리, 종합공조 및 신사업(사이니지, 솔루션 등)기술영업 - B2C: B2C채널(베스트샵, 대형유통, 온라인) 영업관리 및 상권별 특성에 맞는 유통채널 관리 - 모바일: 모바일채널(통신사업자, 대리점) 영업관리, Sell-out 판매전략 수립 및 실행	●	●	●	●	●	● (전공무관)	전국
해외영업 (H&A/HE/MC/B2B)	Sales & Marketing	- 국가별 수요/판매 데이터 분석, 제품 판매 전략 수립 및 추진, 해외법인 영업지원 및 유통/거래선 관리(H&A, HE, MC) - 국가별 마케팅 및 영업 전략 수립, 해외 수주 영업 (Pre Sales) 및 사업/고객사/파트너 발굴/제안(H&A, B2B)	●	●	●	●	●	● (전공무관)	서울
CFO부문	Finance	- 회계, 금융, 세무, 통상, IR, M&A 경영관리, 경영전략, 기획관리, 보험 등						●	서울/인천/평택/청주/구미/창원
	IT	- 사내 업무수행에 필요한 IT시스템 구축과 운영 - 신기술(AI, Big Data, Cloud 등)을 활용한 사업지원형 시스템 구축 - 시스템 기반의 PI(Process Innovation)와 Smart Working 환경 구축 - IT인프라 및 정보보안 관련 시스템 구축과 운영 등						● (IT, 보안, 수력, 통계)	서울
본사/본부 공통	생산	- 생산관리: 생산/물류/자재 최적화 관리 및 운영 - 생산기술: 생산 라인 표준화 설계 및 설비 운영	●	●					● (산업공학)
	구매	- 전략구매: 시장 분석(기술/부품/업체), 부품 원가구조 분석 / 가격결정, 협력사 개발/관리, 공급망 관리, 협상/계약 - 개발구매: 설계 단계 부품 개발 및 재료비 관리, 양산 품질/생산성 확보	●	●	●	●	●		서울/인천/평택/구미/창원
	품질	- 품질보증: 개발시험/개발품질보증(HW/SW), 부품품질보증/SQE, 출하품질보증, 고객지원/시장품질관리 - 품질연구: 고객관점 품질연구, 신뢰성, 부품품질기술, PL/안전, 규격/규제, 환경/에너지 연구	●	●	●	●	●		
	서비스	- 고객지원: 국내외 고객의 Needs에 따라 Solution 제공 - 품질지원: 제품분석, 고객의 VOC(Voice Of Customer) 파악 - 영업지원: 제품관련 문제처리 및 기술지원, 국내외 고객 관련 회의 지원	●	●	●	●			

※ CTO부문, 소재기술원, H&A사업본부의 서울사업장은 석사 이상만 지원 가능

※ 해외영업은 직무 선택 대신 H&A사업분야, HE사업분야, MC사업분야, B2B사업분야 중 선택해야 하며, 한국영업본부에서 일정 기간 근무한 이후 해당 기능부서로 배치함

※ 본사/본부 공통 분야의 경우 신입사원 교육 후 현업부서에 일정 기간 파견교육 후 해당 기능부서로 배치 예정임 (현업부서: 각 본부/부문 R&D 부서)

※ CFO부문과 본사/본부 공통 분야의 근무지는 개인별 면접 결과에 따라 배치 예정임.

※ 당사 채용계획에 따라 본인이 지원하지 않은 본부/직무로 검토 및 배치될 수 있음